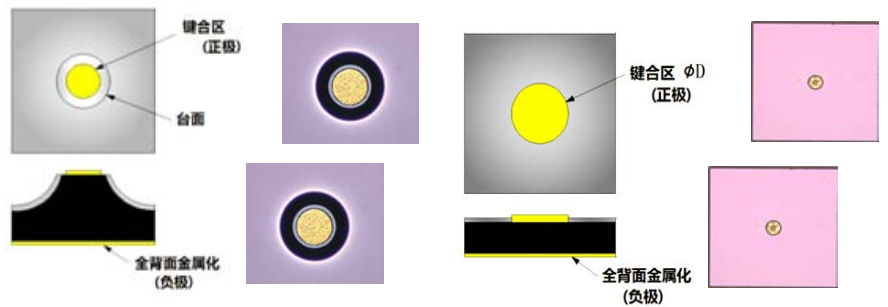


1.1 硅基PIN二极管芯片

特点

- 台面或平面结构
- 中低压芯片采用双层介质膜钝化工艺
- 高压芯片采用玻璃钝化工艺
- 低插损、高隔离、高耐受功率
- 芯片可定制化



应用

- 射频开关、移相、衰减电路等

表1 中低电压硅基PIN二极管芯片常温主要电参数

产品型号	反向电压 VR (V)	零偏结电容 Cj (pF)	负偏结电容 Cj (pF)		串联电阻 Rs (Ω)		少子寿命 τ (ns)	热阻 Rth (°C/W)	I 层厚度 (μm)	电极尺寸 ØD (μm)	芯片尺寸 (μm)	替代型号
	最小	典型	最大	典型	最大	典型	典型	典型	典型	典型	典型	-
测试条件	IR ≤ 10 μA	f=1MHz VR=0V	f=1MHz VR=40V		IF=10mA f=500MHz		IF=10mA IR=6mA	IF=500mA tW=10ms	-	-	-	-
WP0028H	50	0.10	0.05	0.04	2.0	1.9	20	40	5	38	350*350*150	APD0505
WP0029H	50	0.20	0.10	0.08	1.5	1.2	40	35	5	58	350*350*150	APD0510
WPX0043H	50	0.25	0.20	0.12	1.0	0.8	50	33	5	70	350*350*150	APD0520
在研	50	0.20	0.15 @-10V	-	1.2	-	100	-	5	-	350*350*150	SMP1340-099
WP32X	50	-	0.50	-	-	2.0 @50mA	-	-	-	80	300*300*150	定制产品
WPX0035	50	0.22	-	0.12 @-5V	-	0.8	-	-	-	60	300*300*150	定制产品
WPX0036	35	0.26	-	0.13 @-5V	-	1.0 @5mA	-	-	-	50	300*300*150	定制产品
WPX0037	175	0.32	-	0.13 @-20V	-	0.8	-	-	-	150	300*300*150	定制产品
在研	50	0.23	0.175	-	0.9	-	400	-	7	-	350*350*150	SMP1320-099
在研	50	1.10	0.85	-	-	0.45	400	-	7	-	350*350*150	SMP1322-099
WPX0041H	100	0.06	0.05	0.04	2.0	1.7	90	42	8	55	350*350*150	MPN7310 APD0805
WPX0049H	100	0.15	0.10	0.08	1.5	0.8	160	32	8	75	350*350*150	APD0810
WK0004	100	0.06	0.05	0.04	2.0	1.5	100	40	8	40	350*350*150	定制产品
在研	200	0.18	0.15	0.10	1.5	0.9	250	30	10	95	350*350*150	GC42508
在研	100	-	0.20 @-5V	-	2.0	-	100	-	10	-	350*350*150	SMP1345-099
在研	100	0.18	0.15	-	2.0	-	400	-	12	-	350*350*150	SMP1321-099
WP0017H	100	0.12	0.10	0.06	1.5	1.1	150	32	13	75	350*350*150	MA4P161
在研	100	0.15	0.15	0.10	1.5	1.0	150	32	13	75	350*350*150	MA4P203